輔仁大學暨附設機構研發成果專利申請表

案件編號（產學中心填寫）

【專利申請表1】

**2022.08版**

1. 以下所載欄位內容請如實填報，若因填報錯誤或遺漏使本專利申請案遭核駁或其他致本校受有損失之情事，將影響創作人未來申請專利之權益。
2. 本人了解並同意輔仁大學，為專利申請、維護、核駁答辯、績效統計、研發成果推廣媒合、技術移轉/授權洽談之目的，蒐集、處理、利用本申請表所提供之資料。
3. 以下所載之技術內容確為本人創作研發，其智慧財產權非歸屬或涉及或包含第三人之智慧財產權屬，若致生爭議或損害，本人同意出面解決並負擔相關責任。

發明人或創作人代表簽名： 日期：

提案日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.申請專利名稱**  ─此為暫訂，與正式申請時可能不同，請簡短明確的表示與專利內容相符之名稱 | （中文） | | | | | | | | | | |
| （英文） | | | | | | | | | | |
| **2.本申請案之發明或創作人代表**  ─此作為本案程序進行中之聯絡窗口 | 單位/職稱 | | |  | | | | 聯絡電話 | |  | |
| 姓 名 | | |  | | | | 電子郵件 | |  | |
| **3.發明人或創作人**  ─本欄資訊多用於正式專利申請書與聯繫，請確定資料正確無誤  ─衍生收入分配比例係未來取得專利權後且因該專利權所獲收益之分配依據，所有創作人總和應為100%  ─發明人如超過4人，請自行複製本頁  ─聯絡電話、電子郵件請填最容易找到創作人之電話與電子郵件，也可填一個以上 | 本案發明人或創作人共 位 | | | | | | | | | | |
| 1 | 中文姓名 | | | |  | | | 貢獻比重 | | % |
| 英文姓名 | | | | (需與護照使用者相同) | | | 身分證字號或護照字號 | |  |
| 服務單位/職稱 | | | |  | | | 國 籍 | |  |
| 聯絡方式 | | | | 電 話 |  | | | | |
| E-mail |  | | | | |
| 戶籍住址 |  | | | | |
| 2 | 中文姓名 | | | |  | | | 貢獻比重 | |  |
| 英文姓名 | | | | (需與護照使用者相同) | | | 身分證字號或護照字號 | |  |
| 服務單位/職稱 | | | |  | | | 國 籍 | |  |
| 聯絡方式 | | | | 電 話 |  | | | | |
| E-mail |  | | | | |
| 戶籍住址 |  | | | | |
| 3 | 中文姓名 | | | |  | | | 貢獻比重 | | % |
| 英文姓名 | | | | (需與護照使用者相同) | | | 身分證字號或護照字號 | |  |
| 服務單位/職稱 | | | |  | | | 國 籍 | |  |
| 聯絡方式 | | | | 電 話 |  | | | | |
| E-mail |  | | | | |
| 戶籍住址 |  | | | | |
| 4 | 中文姓名 | | | |  | | | 貢獻比重 | |  |
| 英文姓名 | | | | (需與護照使用者相同) | | | 身分證字號或護照字號 | |  |
| 服務單位/職稱 | | | |  | | | 國 籍 | |  |
| 聯絡方式 | | | | 電 話 |  | | | | |
| E-mail |  | | | | |
| 戶籍住址 |  | | | | |
| **4.本申請案技術來源**  ─本欄資訊涉及與資助機關之關係、以及向資助機關呈報登錄之用，請確定資料正確無誤。 | 計畫經費  補助來源 | | | | □科技部（處別： ） （請檢附【計畫核定清單影本】）  □ 經濟部 □ 衛福部 □ 農委會 □ 本校計畫  □ 其他合作單位名稱： (請提供計畫名稱及合約書)  □ 產學合作計畫，合作廠商：  □ 利用本校資源，自行研發 | | | | | | |
| 計畫名稱 | | | |  | | | | | | |
| 計畫經費 | | | | (請檢附【計畫合約影本】) | | | | | | |
| 執行期間 | | | | 自 年 月 日 至 年 月 日 | | | | | | |
| 權利歸屬 | | | | □輔仁大學  □共有：與 共有(請述明共有單位名稱)，  共有比例為 ％(輔大)： ％(共有單位)  □其他： | | | | | | |
| **5. 本申請案公開情形**  ─本欄資訊將用於正式專利申請書，請確定資料正確無誤  ─如已公開，未來提出申請時並須提交相關佐證資料。   * **請先仔細閱讀說明，再填寫此欄。** | □本創作內容係學術發表之一部分  □已參加或預計參加論文口試，口試時間：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。  檢附：口試保密同意書暨簽到表影本及論文紙本延後公開簽呈影本。  □已投稿或預計投稿於\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_期刊，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日線上公開、\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日紙本公開。  檢附：期刊封面&發表文章影本及線上公開資料列印。  □已參加或預計參加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_研討會，發表日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。  檢附：研討會論文集封面、發表文章影本等包含發表場合、日期、發表內容之證明資料  □其他(如科技部計畫)：計畫成果報告/將於\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日線上公開。  檢附：成果報告電子檔，或其線上公開資料連結。 | | | | | | | | | | |
| □本創作內容已參加展覽或競賽  已參加或預計參加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_展覽/競賽，創作內容公開日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。  主辦單位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。 公開程度：□文字□圖片□影片□實體□接受採訪  檢附：展覽或競賽之DM、海報、報名表、照片、相關採訪影片或刊物等包含發表場合、時間、發表內容之證明資料 | | | | | | | | | | |
| □個人發表情形  □已接受或預計接受\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_刊物/新聞採訪，刊出日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。  公開程度：□文字□圖片□影片□實體拍攝  檢附：採訪影片、刊物內容等包含發表場合、時間、發表內容之證明資料。  □已發表或預計發表於FaceBook、Blog、ÝouTube…等，發表日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。  檢附：螢幕擷取畫面、網址等包含發表時間、發表內容之證明資料。 | | | | | | | | | | |
| □本創作尚未發表但有其他發表計畫。  預計於\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日發表於\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。 | | | | | | | | | | |
| □本創作尚未發表且未來無發表計畫 | | | | | | | | | | |
| **※說明：**  1.根據中華民國及美國專利法規定，凡案件於申請前己見於刊物或公開發表（**含學位論文口試、學位論文電子全文及電子書目資料(含摘要)上網、學位論文紙本全文上架、學術刊物發表、學術研討會發表、媒體報導、上課講習、公開演講、參加政府主辦之展覽會、競賽發表…等公開事項**），需於其事實發生後**12個月內向智慧財產局**提出申請方符合申請要件。  2.若已先行公開發表，請註明其發表日期及與專利內容之相關程度。  3.學位論文口試視同公開，若採取以下手段，則可能認為不算公開(1)口試會議不以網路公告(2)口試時關門不讓聽眾自由進出，避免對不特定人士揭露技術(3)所有參加口試會議者簽署保密同意書(若有簽屬請提供影本一份)。  4.**學位論文繳交提醒**：論文電子全文、電子書目資料(含摘要)及紙本論文若於網路上或圖書館供人查詢或閱覽也算是公開，若欲採取保密措施需於(1)本校電子學位論文服務系統**上傳論文電子全文**時，於系統上勾選電子全文延後公開，並另行填寫「學位論文延後公開申請書」向圖書館申請(2)**電子書目資料(含摘要)**及(3)**紙本論文延後公開**(注意：若於公開後才向圖書館申請延後公開，則仍以原公開日期為公開日)。  5.為維持申請專利內容之新穎性，請盡量在申請前勿公開相關內容**。若已公開或預計公開請檢附已公開或預計公開之相關文件**。  **簽章： (**提案人請親自簽名) | | | | | | | | | | |
| **6.有關本申請案之關鍵字** | 中文：  英文： | | | | | | | | | | |
| **7.本技術摘要**  請簡短說明本技術的特徵，並以所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途為限，就如同論文的摘要 | (請大約以250字，說明發明/創作的內容特點) | | | | | | | | | | |
| **8.本技術之創作背景**  請描述本技術所欲解決之問題、該問題目前已知的解決技術、方法、這些已知技術的缺失、以及本技術和這些已知技術的不同點、或本技術所能達成的功效 | **(1)發明所欲解決的問題：**係指申請專利之發明或新型所要解決先前技術中存在的問題。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **(2)解決問題之技術手段：**即欲獲得專利保護之主要技術特徵，請條列本案相較於先前技術具有創新、進步或功效等獨特技術部分，做為撰寫申請專利範圍之參考。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **(3)對照先前技術之功效：**係指前述技術手段所產生的技術效果。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **9.本技術的實施方式**  請盡量詳細描述如何實現本創作。如果是一種裝置，本技術包含哪些元件、各元件的功能、元件之間的互動關係；如果本技術是一種程序、製程、方法，本技術包含那些步驟。同時亦請說明本技術實施的環境，例如是搭配哪些其他裝置。**請盡量提供輔助說明圖示、表格、數據等。** |  | | | | | | | | | | |
| **10.產業應用性**  ─請詳細列舉本技術可能應用的層面與方式  ─產業價值(技術創新度/優點)  ─可應用方式／產業／預期產品說明 | 可能應用的層面與方式 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 產業價值 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 可應用方式／產業／預期產品說明，後續商品化計畫 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **11.本申請案是否正在(或將要)進行相關的產學及/或技轉合作案** | ※請提供相關產學及/或技轉合作案名稱與廠商名稱 | | | | | | | | | | |
| **12.申請專利國家及申請理由**─請提出有利資料以輔助本技術提出國外專利申請案。  (1)為何申請該國之詳細理由，請條列詳述。  (2)該申請案之技術產品預估在該國之重要性(市場佔有率、產品之競爭成本...)  (3)申請該國是否有現存或潛在之競爭優勢?  (4)其他有利申請該國之因素 | 專利類別 | | | □ 發明 □ 新型 □ 設計 (註：美國無新型專利) | | | | | | | |
| 申請國家 | | | □ 中華民國 □ 美國 □ 中國大陸 □ 韓國 □ 日本  □ 越南 □ 其他國家： | | | | | | | |
| 申請**中華民國以外**地區之理由： | | | | | | | | | | |
| **13.本技術所屬技術領域** | 資訊與通訊 | | □監控 □無線通訊技術□多媒體與資訊□射頻辨識技術及應用 □數位視/音訊技術□遠距機器對機器服務及應用 □光通訊技術□智慧型資訊系統□環境控制與感知技術 □其他( ) | | | | | | | | |
| 電子與光電 | | □電子及光電構裝技術 □電磁/光電訊號檢測 □平面顯示技術  □軟性電子技術 □光電與能源環境 □其他( ) | | | | | | | | |
| 材化與奈米 | | □電子材料與零組件 □光電材料/結構 □化工材料與製程  □紡織□奈米材料技術 □氣體/化學量測 □其他( ) | | | | | | | | |
| 生技與醫藥 | | □藥品 □中草藥 □醫藥 □農業生技 □健康食品 □細胞治療  □生醫材料與組織工程□醫療工程及醫療器材 □檢驗試劑  □生物技術□奈米生醫技術 □美容用品 □其他( ) | | | | | | | | |
| 先進製造與自動化 | | □奈米檢測 □自動光學檢測技術及應用□雷射技術□自動化技術 □電機產業技術□超音波換能技術(含CMUT) □流量/流速量測  □振動/聲量量測 □質量/力量/壓力量測 □其他( ) | | | | | | | | |
| 節源與環境 | | □電池 □能源開發 □環保技術 □節能 □工業安全衛生技術  □其他( ) | | | | | | | | |
| 其他 | | □生活應用 □其他( ) | | | | | | | | |
| **14.技術成熟度** | □量產 □試量產 □雛型 □實驗階段 □概念  □其他( ) | | | | | | | | | | |
| **15.技術價值** | 1. 權利金(技術使用費)：NT$ 萬元  2. 衍生利益金百分比(以產品上市銷售額計算，一般約2%～10%)： % | | | | | | | | | | |

**附件**

□ 01輔仁大學暨附設機構研發成果專利申請費用分攤協議書

□ 02輔仁大學暨附設機構研發成果發明人權益收入分配協議書

□ 03申請權證明書

□ 04若為科技部計畫，請檢附【計畫核定清單影本】

□ 05若為非科技部計畫（如產學合作計畫或其他計畫），請檢附【計畫合約影本】

□ 06學術研究報告（如計畫結案報告、論文）

□ 07已發表或即將發表之文獻，請檢附【發表文件】

□ 08相關文獻陳報表

※請條列與本案技術領域相關之文獻，**包含但不限於**提案人或發明人之相關專利、論文等。

1.專利(包含申請中即已獲證案件，請至少寫出申請國別及申請案號/獲證號)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | 國別 | 申請號 | 專利名稱 |
|  |  |  |  |

2.其他(該文獻若無法於網路上輕易取得，請檢附相關文件影本1份)

□ 09其他 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ 上述表件之電子檔請mail到事業處產學資源整合中心：144533@mail.fju.edu.tw

輔仁大學暨附設機構研發成果專利申請費用分攤協議書

【專利申請表2】

一、研發成果編號：(由產學中心填寫)

二、技術名稱(申請專利名稱)：

三、發明人代表：輔仁大學\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_院/系/所/中心\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_教授

※以「輔仁大學學校財團法人輔仁大學」為申請權人

四、發明人專利申請費用分攤說明：

　　經本研發成果所衍生之相關權益義務，依「輔仁大學暨附設機構研究發展成果及技術移轉管理辦法」辦理。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請勾選下列方案 | 發明人或創作人隸屬單位 | 申請、領證及1-3年費用分攤（%） | | 權益收入分配比例（%） | | | | 4-6年經審議後維護費用分攤（%） | |
| 校/附設機構 | 發明人 | 校 | 發明人 | 院/系/所/中心 | 附設機構 | 校/附設機構 | 發明人 |
|  | 學校 | 90 | **10** | 65 | **30** | 5 | - | 60 | **40** |
|  | 60 | **40** | 25 | **70** | 5 | - | 50 | **50** |
|  | 30 | **70** | 10 | **85** | 5 | - | 30 | **70** |
|  | 附設機構 | 90 | **10** | 5 | **30** | 5 | 60 | 60 | **40** |
|  | 60 | **40** | 5 | **70** | 5 | 20 | 50 | **50** |
|  | 30 | **70** | 5 | **85** | 5 | 5 | 30 | **70** |

※科技部成果，於專利申請過程中發明人應至STRIKE系統登錄、答辯(含申復、補充、修正…等)，以及技術移轉之辦理。

※長年期及經審議不維護之分攤比例:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 維護費用分攤（%） | 校/附設機構 | 發明人 |
| 第七年起 | 30 | 70 |
| 自費維護 | 10 | 90 |

五、本案經所有發明人一致同意據以該比例為專利費用分攤比率：

1.發明人： （簽章） 日期：中華民國 年 月 日

2.發明人： （簽章） 日期：中華民國 年 月 日

3.發明人： （簽章） 日期：中華民國 年 月 日

4.發明人： （簽章） 日期：中華民國 年 月 日

輔仁大學暨附設機構研發成果發明人權益收入分配協議書

【專利申請表3】

一、研發成果編號：(由產學中心填寫)

二、技術名稱(擬申請專利名稱)：

三、專利申請號： 證書號：

四、發明人專利申請費用分攤說明：

　　經本研發成果所衍生之相關權益收入，將依「輔仁大學暨附設機構研究發展成果及技術移轉管理辦法」辦理。若發明人為一人以上，請自行協調貢獻比例以為權益分配依據，並於下表填寫權益收入分配比例。日後有關發明人權益收入分配，將依此原則辦理之。(校外人士請提供身分證正反影印本)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **編號** | **發明人** | **權益收入**  **分配比例** | **郵局局帳號** |
| 1 |  | % |  |
| 2 |  | % |  |
| 3 |  | % |  |
| 4 |  | % |  |
| 5 |  | % |  |
| 總計 | | 100 % |  |

四、本案所有發明人一致同意上表權益收入分配比例：

1.發明人： （簽名及蓋私章）日期：中華民國 年 月 日

2.發明人： （簽名及蓋私章）日期：中華民國 年 月 日

3.發明人： （簽名及蓋私章）日期：中華民國 年 月 日

4.發明人： （簽名及蓋私章）日期：中華民國 年 月 日

5.發明人： （簽名及蓋私章）日期：中華民國 年 月 日

申請權證明書

【專利申請表4】

發明人　　　　　　　　　　　　　　　，發明之（名稱）:

「

(由產學中心填寫，列印本文件時，請刪除本行文字，謝謝您!)

」

茲同意將此項申請權讓由 **輔仁大學學校財團法人輔仁大學** 申請專利。

此證

發明人姓名：（簽章）

(1)發明人姓名： （簽名及蓋私章）

身分證字號：

(2)發明人姓名： （簽名及蓋私章）

　 身分證字號：

(3)發明人姓名： （簽名及蓋私章）

　 身分證字號：

(4)發明人姓名： （簽名及蓋私章）

身分證字號：

(5)發明人姓名： （簽名及蓋私章）

身分證字號：

中 華 民 國 年 月 日